

# 苏州国芯科技股份有限公司

## 2024年2月29日至3月1日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	银河基金；长盛基金；嘉合基金；创金合信基金；申万宏源证券；民生证券；德邦证券；华能贵诚信托；华泰资产；阳光资产；人寿养老；深圳福鸿达投资；鹤禧投资；北京衍航投资；上海肇万资产
时间	2024年2月29日13:30；2024年2月29日14:30；2024年3月1日13:30
地点	上海锦江汤臣洲际大酒店会议室；无锡君来世尊酒店会议室
上市公司参加人员姓名	证券事务代表：龚小刚先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。投资者提问的问题主要如下：</p> <p><b>1、请介绍一下公司汽车电子芯片的研发进展情况？</b></p> <p>答：2023年，公司为大力发展汽车电子芯片和面向服务器的高可靠存储控制芯片，持续较大规模投入产品与技术研发，研发费用比上年增长85.36%，其中主要增长是用于汽车电子芯片的研发。</p>

	<p>公司在汽车电子芯片领域陆续推出了中高端汽车电子 MCU 芯片 CCFC3007PT 和 CCFC3008PT、汽车电子 PSI5 收发器专用芯片 CIP4100B、安全气囊点火驱动专用芯片 CCL1600B、汽车智能座舱音响和主动降噪 DSP 芯片 CCD5001 等新产品。汽车电子芯片均按照汽车电子等级进行设计和生产，具备可靠性与功能安全性。</p> <p>公司今年还将有更多在研的高端产品 MCU、SOC 推出面向市场，目前在研的重要产品包括多核高性能汽车电子 MCU（用于高端的动力控制和域控制等）CCFC3012PT、底盘驱动芯片 CCL2200B、智能传感芯片 CMA2100B、门控专用芯片 CCL1100B 芯片、无刷电机控制 CBC2100B 和 NFC 射频收发 CN7160 芯片等。值得一提的是，正在开发的 CCFC3009PT 芯片是面向辅助驾驶领域和滑板底盘应用而设计开发的 MCU 芯片，采用高性能 RSIC-V 架构（6 个主核+4 个锁步核），算力更高可达到 6000DMIPS 以上。</p> <p>公司目前在汽车电子芯片领域已经建立起较为丰富完整的产品线，未来还将不断推出面向市场的新产品，持续突破在汽车电子等关键领域的市场和技术壁垒，积极开拓市场和客户。</p> <p><b>2、公司的云安全芯片产品是否有新的进展？</b></p> <p>答：公司围绕自主云安全芯片持续进行新一代产品技术研发，对已有自主云安全芯片与应用进行技术升级迭代，公司已立项开发融合了神经网络计算 NPU 技术的新一代云安全超高速加解密芯片，其加密模块 SM2 签名性能可达 100 万次/秒，SM4 加密性能可达 80Gbps/秒，性能提升达到数倍，可满足超高端云安全应用需求，目前相关产品正在积极研发过程中。</p> <p><b>3、截止 2023 年底，公司已经实现量产出货的车规级芯片产</b></p>
--	---

	<p><b>品都有哪些？</b></p> <p>答：公司目前已量产的汽车电子芯片应用领域涵盖车身与网关控制、安全气囊、线控底盘、域控制器、车联网安全、动力总成、仪表等，在安全气囊控制、车身控制等应用型号都超过 50 万颗，特别是在安全气囊控制方面型号产品已经销售超过 200 万颗。</p> <p><b>4、请介绍一下公司在量子芯片的布局情况？</b></p> <p>答：信创和信息安全是公司业务的重要组成部分，公司持续采用量子技术对信创和信息安全芯片产品进行升级，提升并拓展公司信创和信息安全产品线。2022 年，公司与硅臻首次合作，成功研发了基于国芯科技 CCP903T 高性能密码芯片和硅臻 QRNG25SPI 量子随机数发生器模组的高速量子密码卡，可广泛应用于密码机、签名/验证服务器、安全网关/防火墙等安全设备以及金融、物联网、工业控制、可信计算和国家重大需求等领域。2023 年，公司与问天量子、文芯科技签署了战略合作协议，三方合作成立量子芯片联合实验室，面向互联网、物联网、人工智能、云计算、先进存储和通信基础设施等领域，共同研发应用于云-边-端的量子密码芯片；并针对上述应用场景，开发量子信息安全方案、技术及产品。近日，公司与硅臻签署了战略合作协议，双方将组建智能终端量子安全芯片联合实验室，基于公司的 ET 系列智能终端信息安全芯片和硅臻的 QRNG-10 量子随机数发生器芯片联合发展智能终端量子安全芯片技术和产品。硅臻同时也是公司的参股企业。</p>
<p><b>附件清单</b> <b>(如有)</b></p>	<p>无</p>

---

日期	2024年3月
----	---------